

Title (en)
PRINTED BOARD FOR THE SURFACE SOLDERING OF INTEGRATED MINIATURE CIRCUITS AND MANUFACTURING METHOD OF SUCH PRINTED BOARDS.

Title (de)
LEITERPLATTE ZUM AUFLÖTEN VON INTEGRIERTEN MINIATURSCHALTUNGEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SOLCHEN LEITERPLATTEN.

Title (fr)
CARTE IMPRIMEE POUR LE MONTAGE EN SURFACE DE CIRCUITS INTEGRES MINIATURE ET PROCEDE DE FABRICATION DE TELLES CARTES IMPRIMEES.

Publication
EP 0144413 A1 19850619 (DE)

Application
EP 84902450 A 19840615

Priority
DE 3321694 A 19830615

Abstract (en)
[origin: DE3321694A1] Printed board for the surface soldering of integrated miniature circuits having connection arms which may be flat mounted at the surface. The printed board (3) has one or a plurality of recesses (4) for receiving and latching the integrated miniature circuit (1) in a position wherein the connection arms (2) of the integrated miniature circuit are orientated towards their mounting points (6). The metallized recesses (4) for the latching of the connection arms (2) may also be provided with traversing metallized capillary holes (5) for the underside mountings of the board. Methods for producing such a printed board by etching a profiled model and metallizing at least one electrically conducting layer are also disclosed. The etching of a profiled model followed by a metallization enables particularly a fixed positioning of the integrated miniature circuits.

Abstract (fr)
Carte imprimée pour le montage en surface de circuits intégrés miniature possédant des bras de connexion pouvant être montés en surface à plat. La carte imprimée (3) possède un ou plusieurs évidements (4) pour accueillir par encliquetage le circuit intégré miniature (1) dans une position où les bras de connexion (2) du circuit intégré miniature sont orientés vers leurs points de montage (6). Les évidements métallisés (4) pour l'encliquetage des bras de connexion (2) peuvent également être dotés de trous capillaires métallisés traversant (5) pour les montages du dessous de la carte. Sont aussi décrits des procédés de fabrication d'une telle carte imprimée par gravage d'un modèle de profilage, puis métallisation d'au moins une couche électriquement conductrice. Le gravage d'un modèle de profilage suivi d'une métallisation permet en particulier le positionnement fixe des circuits intégrés miniature.

IPC 1-7
H05K 3/40; **H05K 1/18**

IPC 8 full level
H05K 1/11 (2006.01); **H05K 3/34** (2006.01)

CPC (source: EP)
H05K 1/113 (2013.01); **H05K 3/3421** (2013.01); **H05K 3/3468** (2013.01); **H05K 2201/09036** (2013.01); **H05K 2201/09472** (2013.01); **H05K 2201/09845** (2013.01); **H05K 2201/10689** (2013.01); **H05K 2203/0455** (2013.01); **Y02P 70/50** (2015.11)

Citation (search report)
See references of WO 8500085A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)
DE 3321694 A1 19841220; EP 0144413 A1 19850619; WO 8500085 A1 19850103

DOCDB simple family (application)
DE 3321694 A 19830615; EP 8400177 W 19840615; EP 84902450 A 19840615